

iR730B-002

ソフトバンクネットワーク対応の5Gエッジゲートウェイ、iR730B-002のご紹介です。



iR730B-002

株式会社 I D Y

5Gエッジゲートウェイ

産業向け耐ノイズ、耐温度、耐振動、耐衝撃



スペック

製品名/型番	iR730B-002
サイズ	77.9mm×125（取付耳 145）mm×24.8mm（H×W×D）
内蔵モジュール	SIM8202G-M2(R2)
重量	約320g（WISE CONNECT™モジュール、アンテナ、ACアダプター含まず）
通信方式	5G/FDD-LTE/TDD-LTE
通信機能	パケット通信
周波数	5G：n3/n28/n77 FDD-LTE：B1/B3/B8/B28 TDD-LTE：B41/B42 ※ HPUe非対応
電源電圧	DC5-16V入力、ACアダプター（AC100V～240V DC12V 出力）付属
消費電流	通信時：1700mA（最大） 待機時：250mA（最大）
外部インターフェース	LAN x 1、WAN/LAN x 1、USB2.0、DIO x 2
動作環境	動作温度：-10～60℃
取得済み認証	取得済み認証：JATE/TELEC 自社適合： ・VCCI Class B ・自動車部品振動試験規格 JIS D1601:1995 ・鉄道車両用品振動及び衝撃試験 JIS E 4031:2013
USIMサイズ	nano SIM

本製品は株式会社 I D Y および販売代理店より販売します。詳しくは営業窓口にお問い合わせください。

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.idy-design.com/>

※パンフレットの記載内容は、2023年10月1日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。